

Title (en)  
Copper casting alloy

Title (de)  
Kupfergusslegierung

Title (fr)  
Alliage de fonte au cuivre

Publication  
**EP 2960350 A1 20151230 (DE)**

Application  
**EP 14002217 A 20140627**

Priority  
EP 14002217 A 20140627

Abstract (de)  
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupfergusslegierung enthaltend: 80 bis 95 Massenprozent Cu; 5-20 Massenprozent Sn und/oder Zn; und > 0% bis 1,0 Massenprozent Sr. Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Kupfergusslegierung anzugeben, deren Verbau beispielsweise in Wasserleitungen die scharfen Pb-Grenzwerte einhalten kann und jedoch zumindest in Bezug auf die spanbrechenden Eigenschaften vergleichbar mit bleihaltigen Kupfergusslegierungen ist und wirtschaftlich herzustellen ist. Zudem wird u.a ein Verfahren zur Herstellung einer Kupfergusslegierung angegeben.

IPC 8 full level  
**C22C 9/02** (2006.01); **C22C 9/04** (2006.01); **C22F 1/08** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**C22C 9/02** (2013.01); **C22C 9/04** (2013.01); **C22F 1/08** (2013.01)

Citation (applicant)

- EP 1600516 A2 20051130 - SAMBO COPPER ALLOY CO LTD [JP]
- WO 2011121799 A1 20111006 - JOETSU BRONZ1 CORP [JP], et al
- WO 9700977 A1 19970109 - ASARCO INC [US]

Citation (search report)

- [AD] WO 9700977 A1 19970109 - ASARCO INC [US]
- [A] EP 2530175 A1 20121205 - MITSUBISHI MATERIALS CORP [JP]
- [X] WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG METALLE ET AL: "Published by the Copper Casting Alloy Department (Gesamtverband der Deutschen Buntmetallindustrie) in the Copper c asting alloys C O N T I N U O U S CASTING QUALITY", 1 January 2011 (2011-01-01), pages 1 - 9, XP055155737, Retrieved from the Internet <URL:http://www.msu-uhl.com/cms/upload/Images\_Header/MSU\_Copper\_Casting\_Alloys\_2011.pdf> [retrieved on 20141128]

Cited by  
CN109628781A; WO2022223673A1

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2960350 A1 20151230; EP 2960350 B1 20171129**

DOCDB simple family (application)  
**EP 14002217 A 20140627**